

ブラシレスモータドライバの設計事例

その他 1 ～オプション機器の製作

: ヒートシンク～

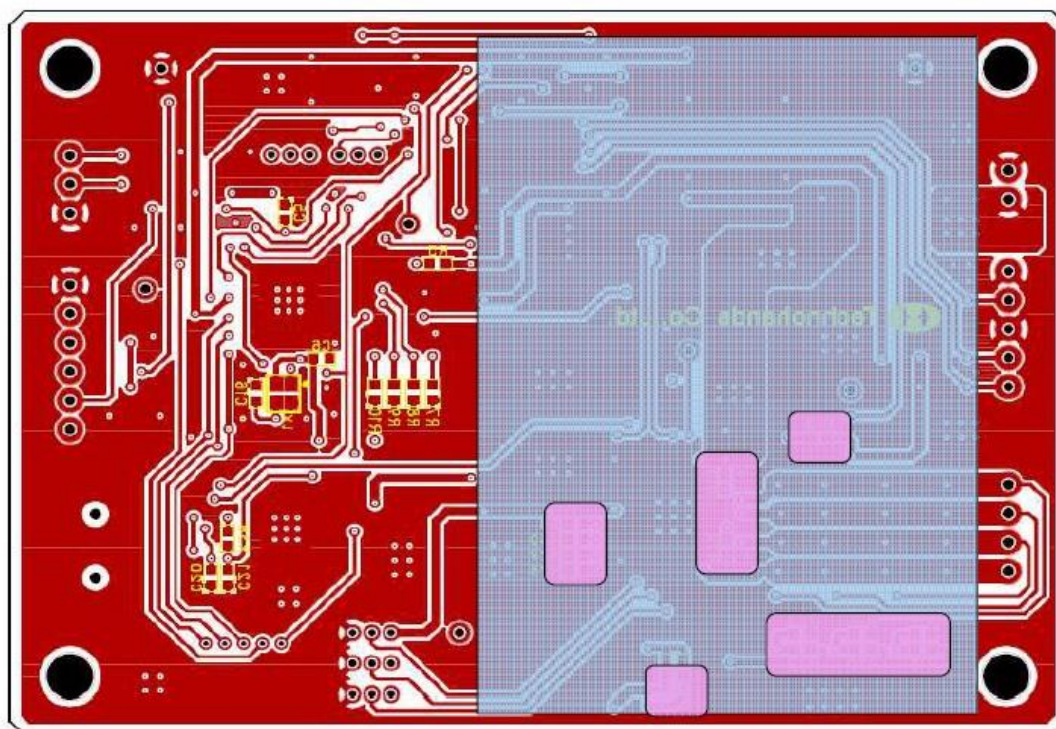
モータを駆動する電流と、MCD のドライブ回路の素子のオン抵抗による電圧降下によって MCD 内部でジュール熱が発生します。多くの MCD は発生した熱を MCD の端子を通じて基板に放熱します。しかしながら基板デザインや設置環境などによっては十分な放熱が得られず MCD や基板上に配置した電子部品の故障を引き起こす要因になります。

この熱を基板に取り付けたヒートシンクから放熱し動作信頼性を向上させる目的でオプションパーツとして製作し、販売します。

ヒートシンク仕様

- 材質： アルミ
- 厚さ： 3mm

ヒートシンク取り付け図



アルミ板ヒートシンク

部品、半田箇所逃げ穴

参考文献

1. 東芝半導体&ストレージ製品 [信頼性ハンドブック](#)

半導体の信頼性全般について記載されています。故障モードの多くが温度に影響されます。

2. 東芝半導体&ストレージ製品 [取り扱い上のご注意とお願い](#)

半導体を扱う上での注意事項が記載されています。放熱の考え方もここに記載されています。